

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年2月1日(01.02.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/024881 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 59/20 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/027516

(22) 国際出願日: 2023年7月27日(27.07.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-121296 2022年7月29日(29.07.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社スリーボンド(**THREEBOND CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 岩澤 淳也 (**IWASAWA, Jyunya**); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP). 今井雄介 (**IMAI, Yusuke**); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP). 三橋 向輝 (**MIHASHI, Koki**); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: IBC 一番町弁理士法人 (**IBC**); 〒1020082 東京都千代田区一番町10番地2 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) Title: EPOXY RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: エポキシ樹脂組成物

(57) Abstract: In cases where a component having a low molecular weight is added to conventional epoxy resin compositions for the purpose of improving the workability thereof, the component having a low molecular weight is likely to volatilize and it is difficult to suppress discharge of outgas. Meanwhile, an epoxy resin composition according to the present invention is capable of suppressing the generation of outgas during a curing process even if a component having a low molecular weight is added thereto for the purpose of workability improvement; and this epoxy resin composition is able to be cured at low temperatures. An epoxy resin composition according to the present invention contains the components (A) to (D) described below; the content of epoxy resins that do not contain an aromatic ring in each molecule is 9.5% by mass or less relative to the total amount of the component (A); and the content of the component (D) is 25% by mass or less relative to the entirety of the composition. Component (A): epoxy resins Component (B): a compound which has two or more thiol groups in each molecule Component (C): a curing accelerator Component (D): a filler

(57) 要約: 従来は、作業性を向上させる目的で分子量が低い成分を添加すると分子量が低い成分が揮発し易く、アウトガスとして排出を抑制することが困難であったが、本発明は作業性を向上させる目的で分子量が低い成分を添加しても硬化時のアウトガス発生を抑制することを可能にすると共に低温で硬化することができる。本発明のエポキシ樹脂組成物は、(A)～(D)成分を含み、(A)成分の合計に対して1分子中に芳香環を含まないエポキシ樹脂が9.5質量%以下であり、(D)成分が組成物全体に対して2.5質量%以下含む。(A)成分: エポキシ樹脂 (B)成分: 1分子中にチオール基を2つ以上有する化合物 (C)成分: 硬化促進剤 (D)成分: 充填剤

WO 2024/024881 A1

[続葉有]

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）